

Title (en)

High current contact for fixing on a pcb and its use

Title (de)

Hochstrom-Kontaktelement zur Befestigung an einer Leiterplattenanordnung und Verwendung eines Hochstrom-Kontaktelements

Title (fr)

Contact à courant fort pour la fixation sur une plaquette à circuits et utilisation d'un tel contact

Publication

EP 1355383 A1 20031022 (DE)

Application

EP 03007269 A 20030331

Priority

DE 10215985 A 20020411

Abstract (en)

The device has a metal contact body (4) and a screw element (5) for connection to the contact body, which has a thread (9) on a first side surface (7) for attaching a high current cable (17) using the screw element. The contact body is in one piece and has a conducting solder zone on a second lateral surface (13) with a flat contact surface or several in a plane. The solder zone is dimensioned to fit on a conducting pad (3) of the circuit board. AN Independent claim is also included for the following: a circuit board arrangement with an inventive device.

Abstract (de)

Ein Hochstrom-Kontaktelement (1) zur Befestigung an einer Leiterplatte (2') weist einen metallischen Kontaktkörper (4) und einen mit dem Kontaktkörper (4) verbindbares Schraubelement (5) auf. Der Kontaktkörper (4) weist an einer ersten Seitenfläche (7) ein Gewinde auf zur Befestigung eines Hochstrom-Kabels (17) mittels des Schraubelements (5) und an einer zweiten Seitenfläche (13) eine leitende Lötzone, die derart dimensioniert ist, dass sie auf einem leitenden Pad (3) der Leiterplatte (2') platzierbar ist. Ein solches Hochstrom-Kontaktelement (1) ist in vorteilhafter Weise in Oberflächenmontage (SMT) zu einer Leiterplattenanordnung (2) zusammenbaubar und eignet sich besonders zur Verwendung in einem Bestückautomaten. <IMAGE>

IPC 1-7

H01R 12/32; **H01R 43/02**

IPC 8 full level

H01R 12/57 (2011.01); **H01R 43/02** (2006.01)

CPC (source: EP)

C22C 9/00 (2013.01); **C22C 9/04** (2013.01); **H01R 12/52** (2013.01); **H01R 43/0256** (2013.01)

Citation (search report)

- [Y] DE 20108731 U1 20010830 - GROTE & HARTMANN [DE]
- [DY] EP 0878868 A2 19981118 - HARTMANN & BRAUN GMBH & CO KG [DE]
- [A] US 5588848 A 19961231 - LAW RONALD L [US], et al
- [A] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1995, no. 04 31 May 1995 (1995-05-31)

Cited by

EP2498290A1; EP2070160A4; CN100440620C; CN102598880A; EP2496060A4; WO2008039310A2

Designated contracting state (EPC)

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LI LU MC NL PT RO SE SI SK TR

DOCDB simple family (publication)

EP 1355383 A1 20031022; DE 10215985 A1 20031106

DOCDB simple family (application)

EP 03007269 A 20030331; DE 10215985 A 20020411